

a cura di: Gian Paolo Collalto - giampa - 03-12-2015 21:00

## Le AMD Arctic Islands arriveranno in estate



LINK (https://www.nexthardware.com/news/schede-video/7239/le-amd-arctic-islands-arriveranno-in-estate.htm)

Prestazioni per watt doppie rispetto alle attuali top di gamma, FinFET a 14 o 16nm e HBM2 per le Radeon 400.



Le schede video AMD di prossima generazione, ovvero le Radeon 400 appartenenti alla famiglia Arctic Islands, hanno solleticato l'appetito di molti utenti, per lo più appassionati di gaming, in quanto rappresentano il primo vero salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza dall'introduzione della serie HD 7000 nel gennaio 2012.

Nonostante le diverse fughe di notizie, vere o presunte tali, ancora oggi non si hanno dettagli specifici sull'architettura delle nuove GPU, al di là dell'impiego di GPU realizzate con processo produttivo a 14 o 16nm in abbinamento a memorie di tipo HBM2.

La nomenclatura Radeon 400, pertanto, assume un significato relativo in quanto usato in questa sede solo per comodità di identificazione della nuova famiglia di schede video, potendo la stessa essere completamente disattesa.

R9 290 e 1.2 per le R9 285, 380 e tutte le Fury, secondo Mark Papermaster, Chief Technology Officer in AMD, l'azienda ne riconosce l'introduzione di solo due identificando la terza↔ e maggiore iterazione sotto forma delle GPU che equipaggeranno Arctic Islands.

I miglioramenti introdotti sulle nuove GPU, quindi, saranno essenzialmente tre rispetto alla attuale line-up di AMD, nello specifico l'adozione di un nuovo processo produttivo a 14 o 16nm, una architettura molto evoluta e l'adozione della seconda generazione di memorie HBM in grado di raddoppiare la larghezza di banda portandola ad 1TB/s.

Il nuovo processo produttivo a 16nm, in particolare, offrirà una densità disponibile doppia, una velocità maggiore del 65% ed una riduzione dei consumi sino al 70% rispetto a quello a 28nm.

Il confronto con l'architettura Pascal di NVIDIA si preannuncia quindi elettrizzante in termini di prestazioni e consumi, con costi all'utente finale che saranno fortemente condizionati dalla resa produttiva e dalla reale disponibilità in volumi dei nuovi FinFET.